



2023 大眾投控

凱基證券法說會

2023/11/23 Copyright © Reserved By FIC Global Inc.

- ▶ 大眾電腦現況
- ▶ 三希集團現況
- ▶ 攸泰科技現況
- ▶ 集團成長引擎



合併資產負債表摘要

單位：新台幣仟元

	2023.09.30	%	2022.09.30	%
現金及約當現金	2,610,415	22	1,233,263	12
應收帳款淨額	2,808,843	23	2,417,762	24
存貨	3,189,213	27	3,570,103	35
不動產、廠房及設備	568,057	5	611,083	6
使用權資產	545,149	5	380,597	4
投資性不動產	916,262	8	956,748	10
總資產	11,951,846	100	10,161,016	100
總負債	5,406,853	45	4,930,345	49
權益總額	6,544,993	55	5,230,671	51



合併綜合損益表摘要

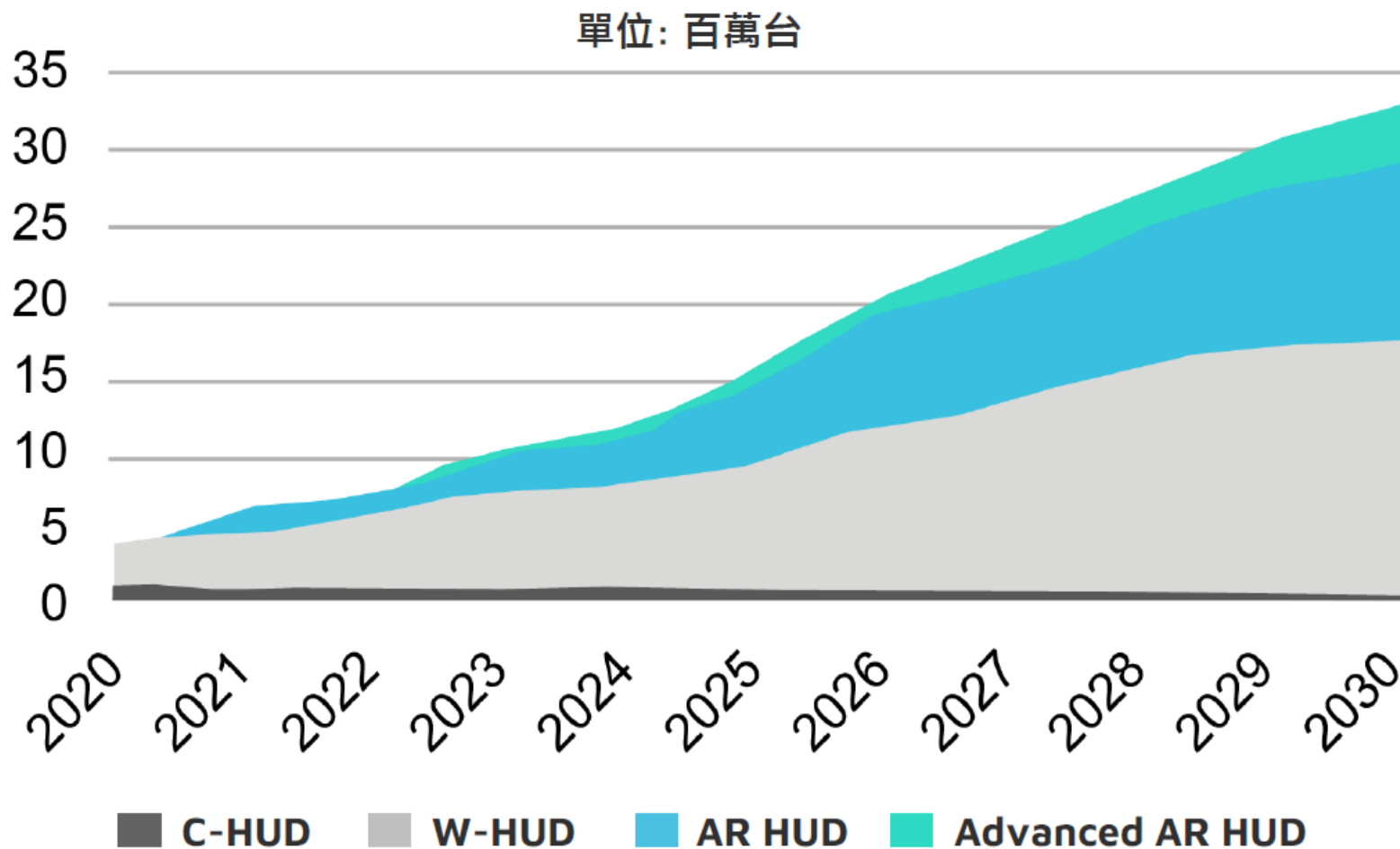
單位：新台幣仟元

	2023.01.01~ 2023.09.30	%	2022.01.01~ 2022.09.30	%
營業收入	10,048,462	100	8,822,344	100
營業成本	(8,362,651)	(83)	(7,680,446)	(87)
營業毛利	1,685,811	17	1,141,898	13
營業費用合計	(1,063,045)	(11)	(858,424)	(10)
營業利益	622,766	6	283,474	3
營業外收入及支出合計	184,084	2	378,257	5
所得稅費用	(148,312)	(2)	(86,956)	(1)
本期淨利	658,538	6	574,775	7
淨利歸屬於母公司業主	372,060	3	371,160	4
基本每股盈餘（元）	1.70		1.74	



大眾電腦 車用電子

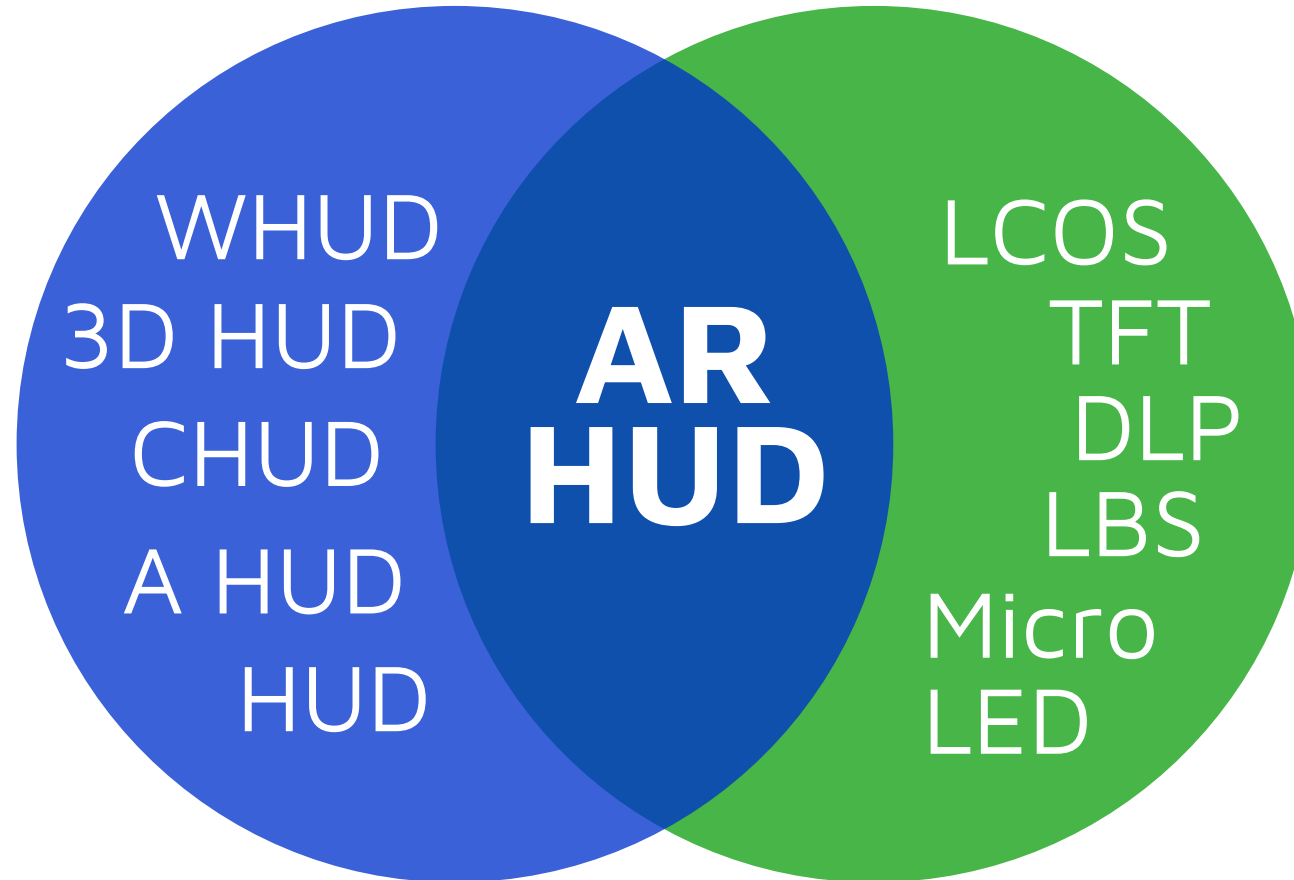
HUD 市場出貨規模



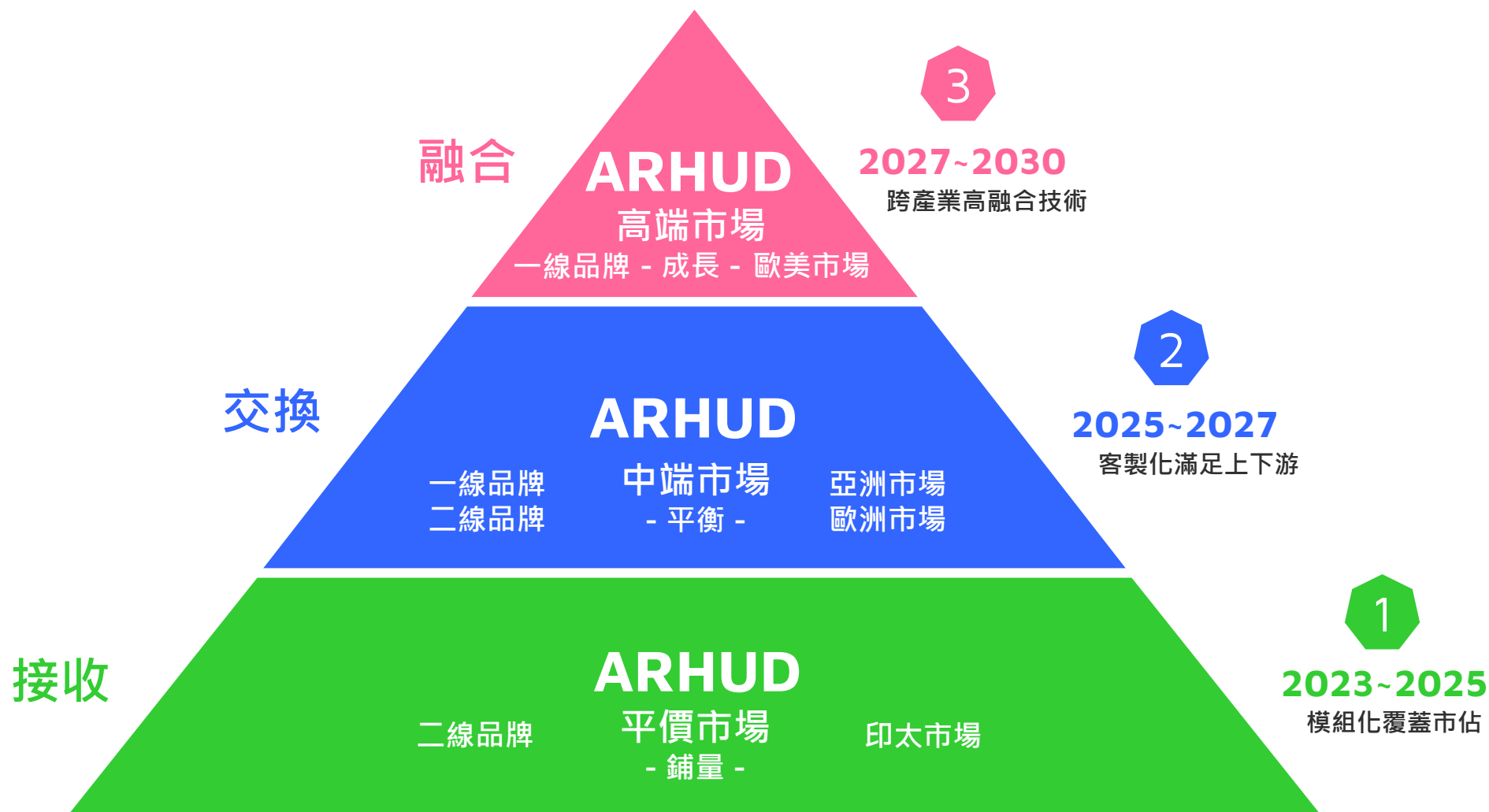
資料來源: 東吳證券



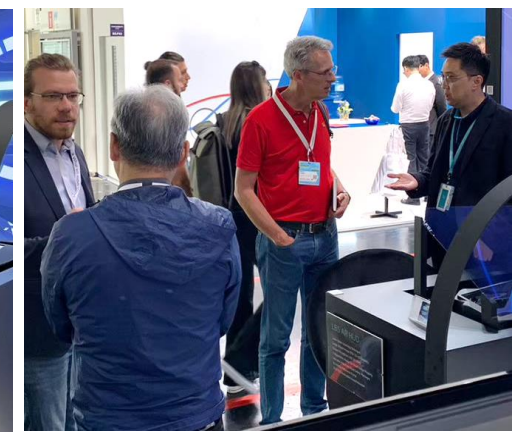
ARHUD 中國市場現況



ARHUD 健康發展三部曲



Germany IAA Mobility



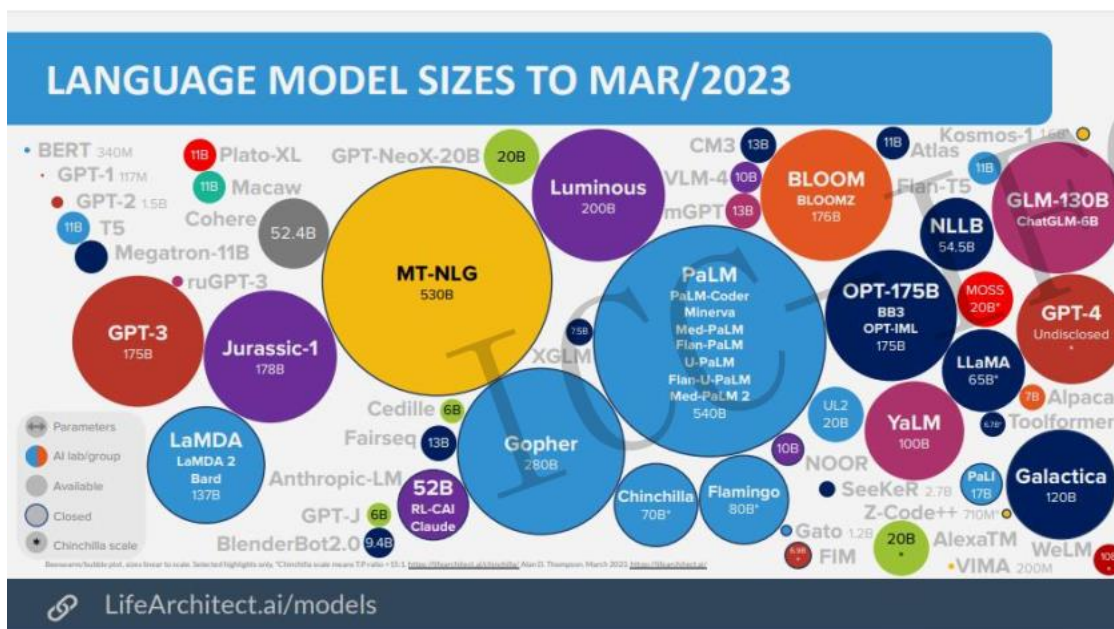
CLUSTER / ECU / ADAS



三希光通信市場狀況

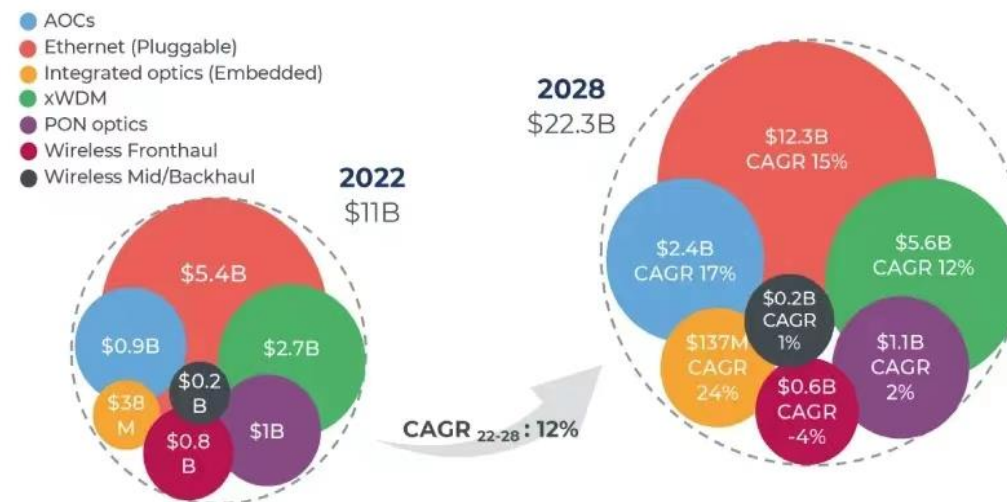
AI浪潮推動高速傳輸需求爆發

800G~1.6T 2024~2025年逐步推動新一波成長動能
光模組需求將在2024迎來爆發式的增長！



2022-2028 OPTICAL TRANSCEIVER REVENUE GROWTH FORECAST BY SEGMENT

Source: Optical Transceivers for Datacom and Telecom 2023 report, Yole Intelligence, 2023



三希光通市場競爭力

產品齊全

從10G~800G光模組量產，並深入1.6T開發，涵蓋所有光模組封裝類型，如CFP、SFP+、QSFP28、OSFP、TXFP、QSFPDD等

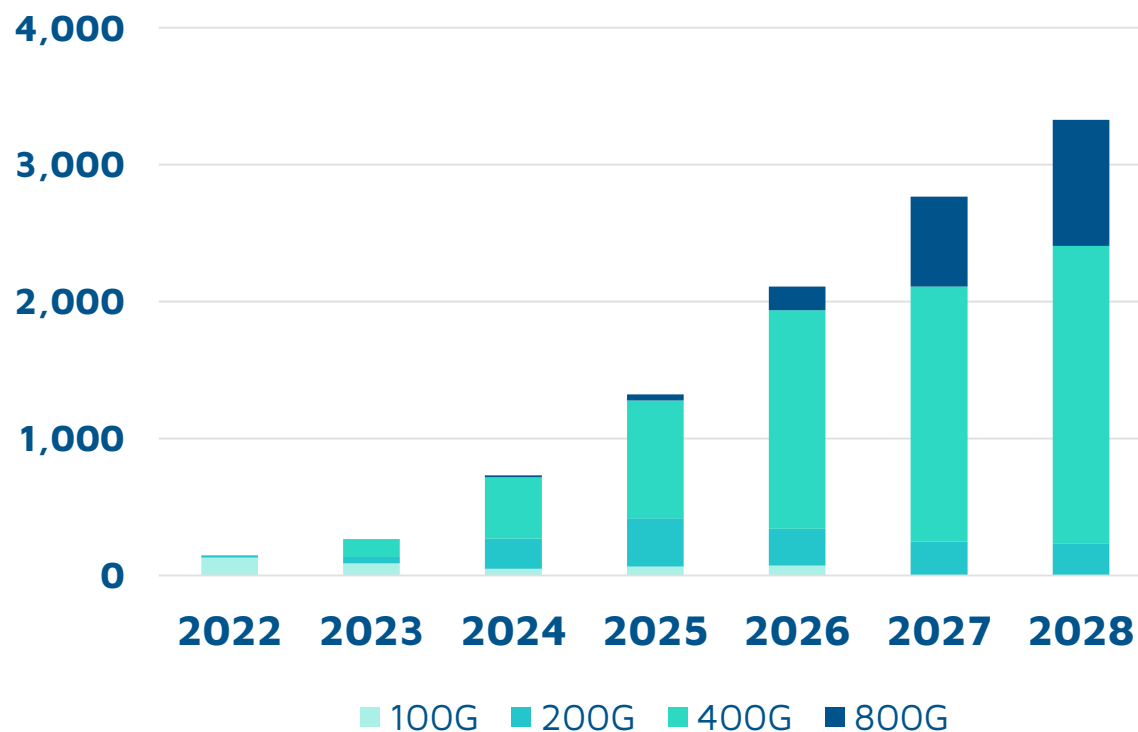
工藝領先

支持008004 (0.25*0.125mm)器件貼片，Bare die COB 工藝，Die/Wire Bonding 等複雜工藝

經驗豐富

超15年光模組產品製造經驗，具有強大的SMT技術團隊

數量單位: K



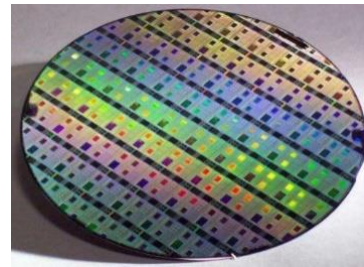
Source: Omdia ; 智璞產業趨勢研究所



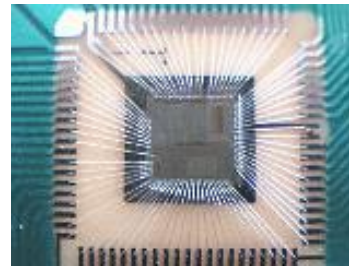
三希半導體封裝

COB

COB 封裝即 Chip On Board，將裸晶片Bare Die用導電或非導電膠粘附在互連基板上，然後進行引線鍵合實現其電氣連接。



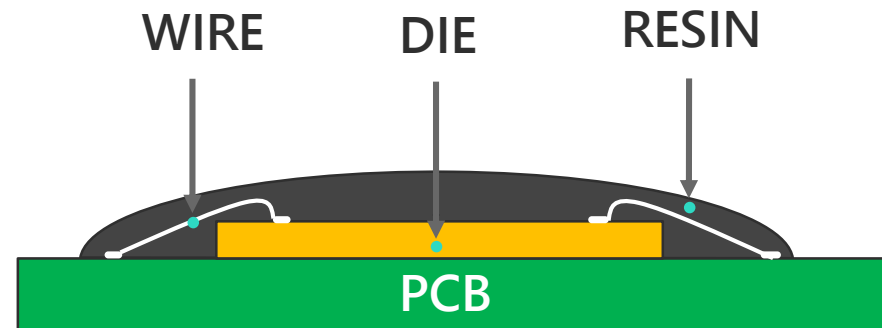
裸晶圓



晶圓置件及打線



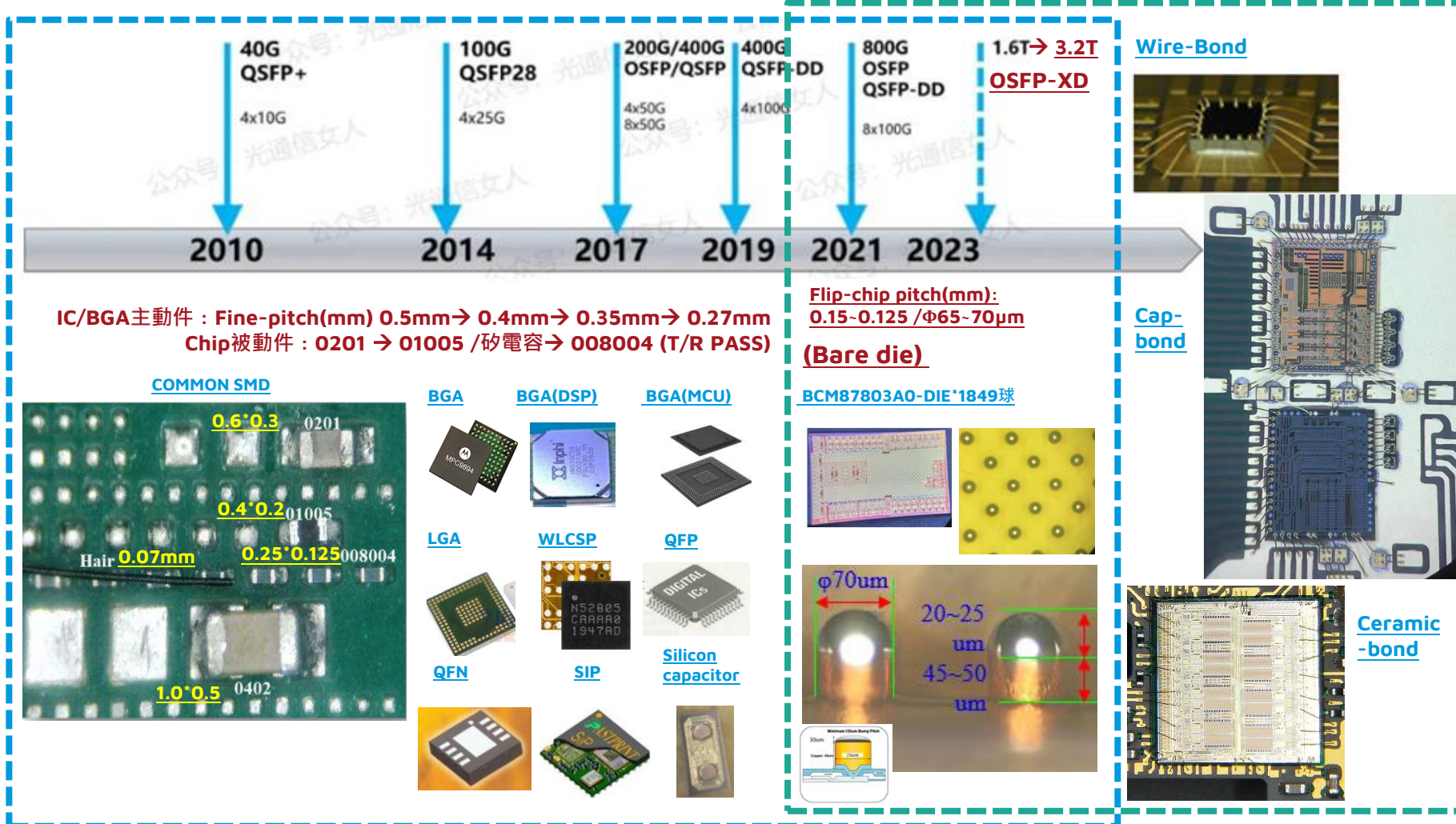
封膠



三希裸晶圓貼片技術進展

SMT

Semicon (COB)



IC/BGA 主動件:

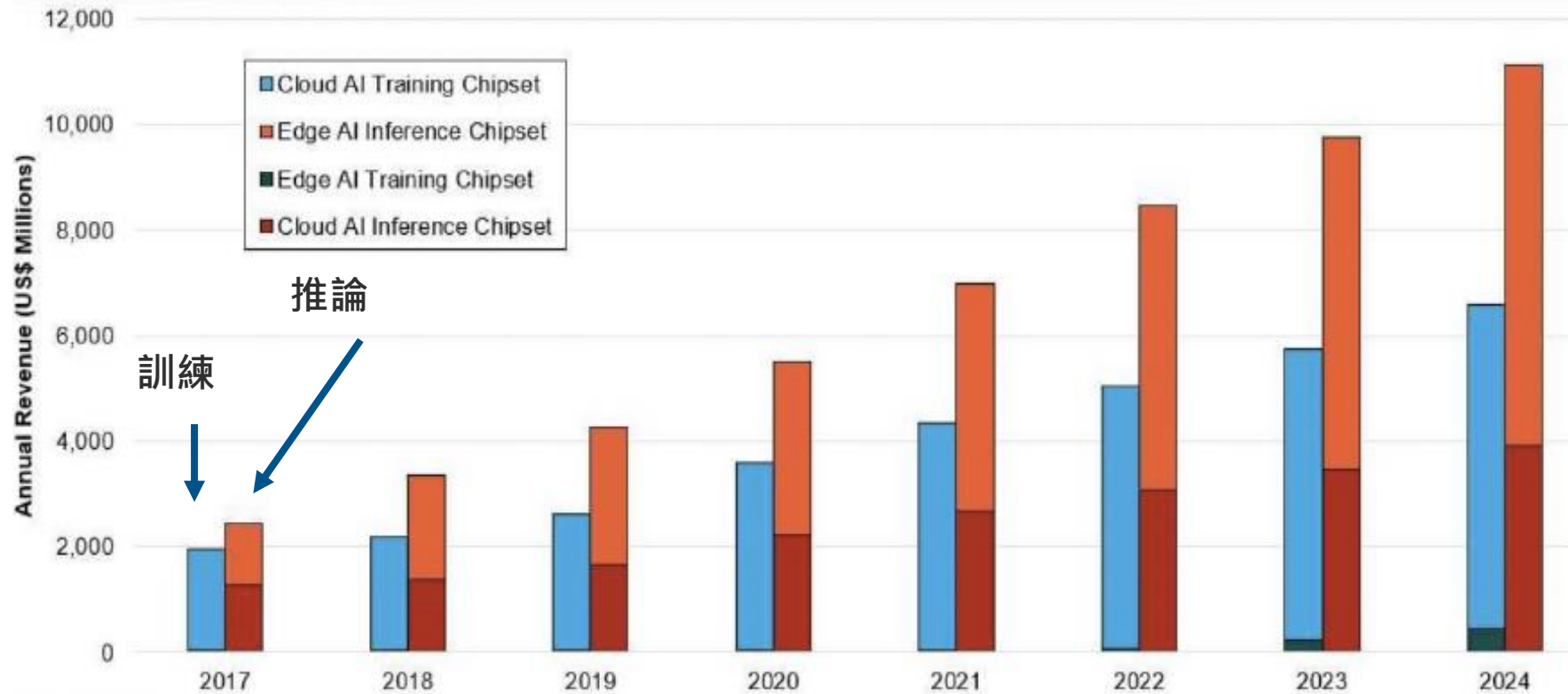
- SMT量產最小量產 0.27mm pitch
- SMT+COB for 800G/1.6T 最小 0.125mm pitch

CHIP 被動件:

- 最小008004(0201M) 2017年具備生產能力
- 01005一次良率99.996% (40dppm) /2022
- 0201一次良率99.999% (10dppm) /2022

Next... AI Server / AI PC

WW AI Chip market(\$M)



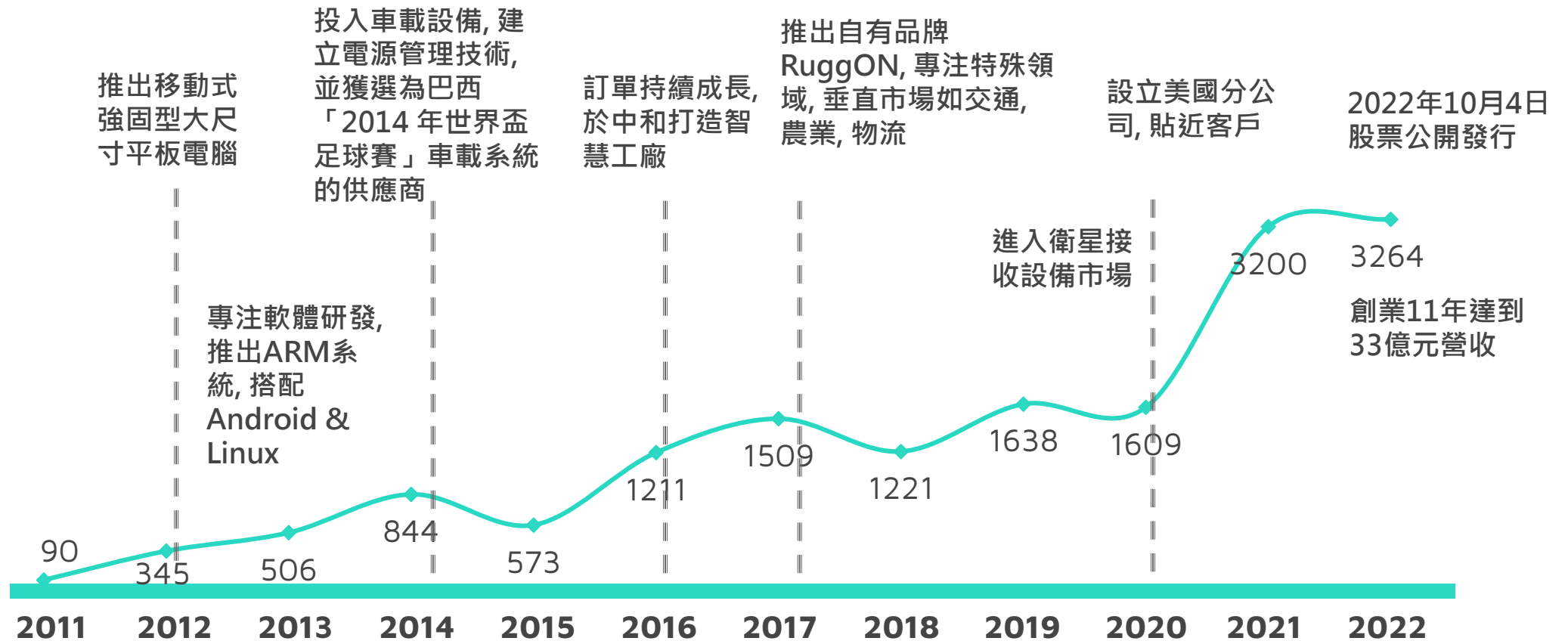
source: ABI Research(Dec.2022) ; 智璞產業趨勢研究所



攸泰科技

成立11年複合成長率為 38%

企業價值



未來規劃

衛星 & 品牌 雙軌並行

企業價值

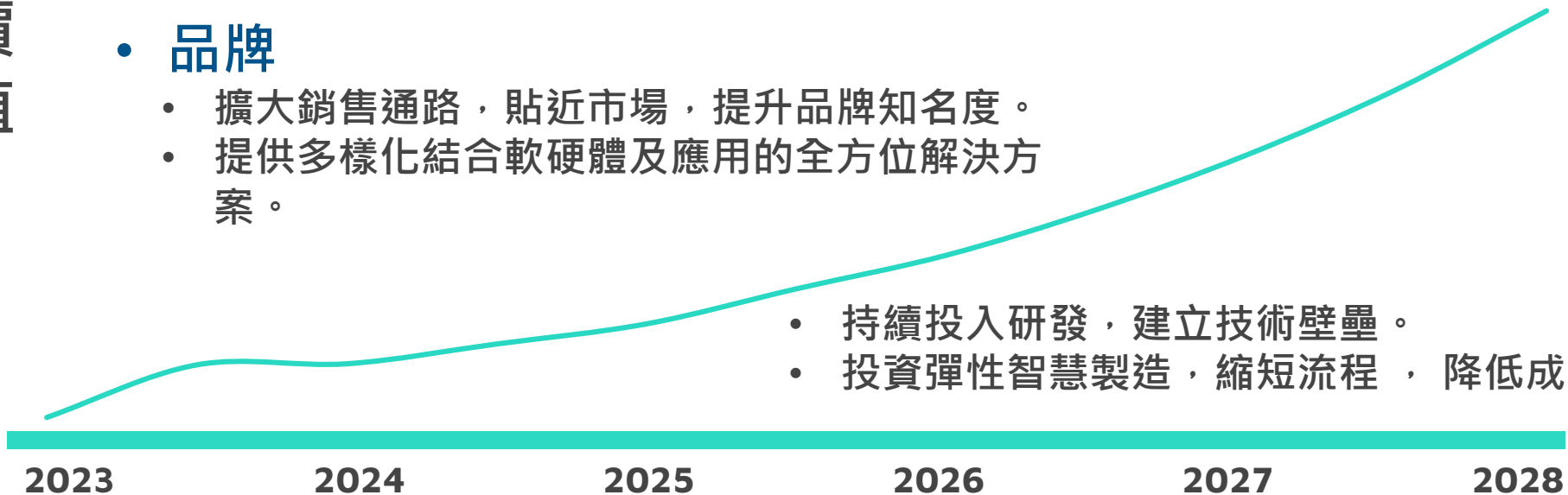
- 衛星

- 建立生態鍊，完備系統整合的能力。
- 拓展市場：GEO → MEO → LEO，成為台灣移動式衛星地面設備市場領導者。

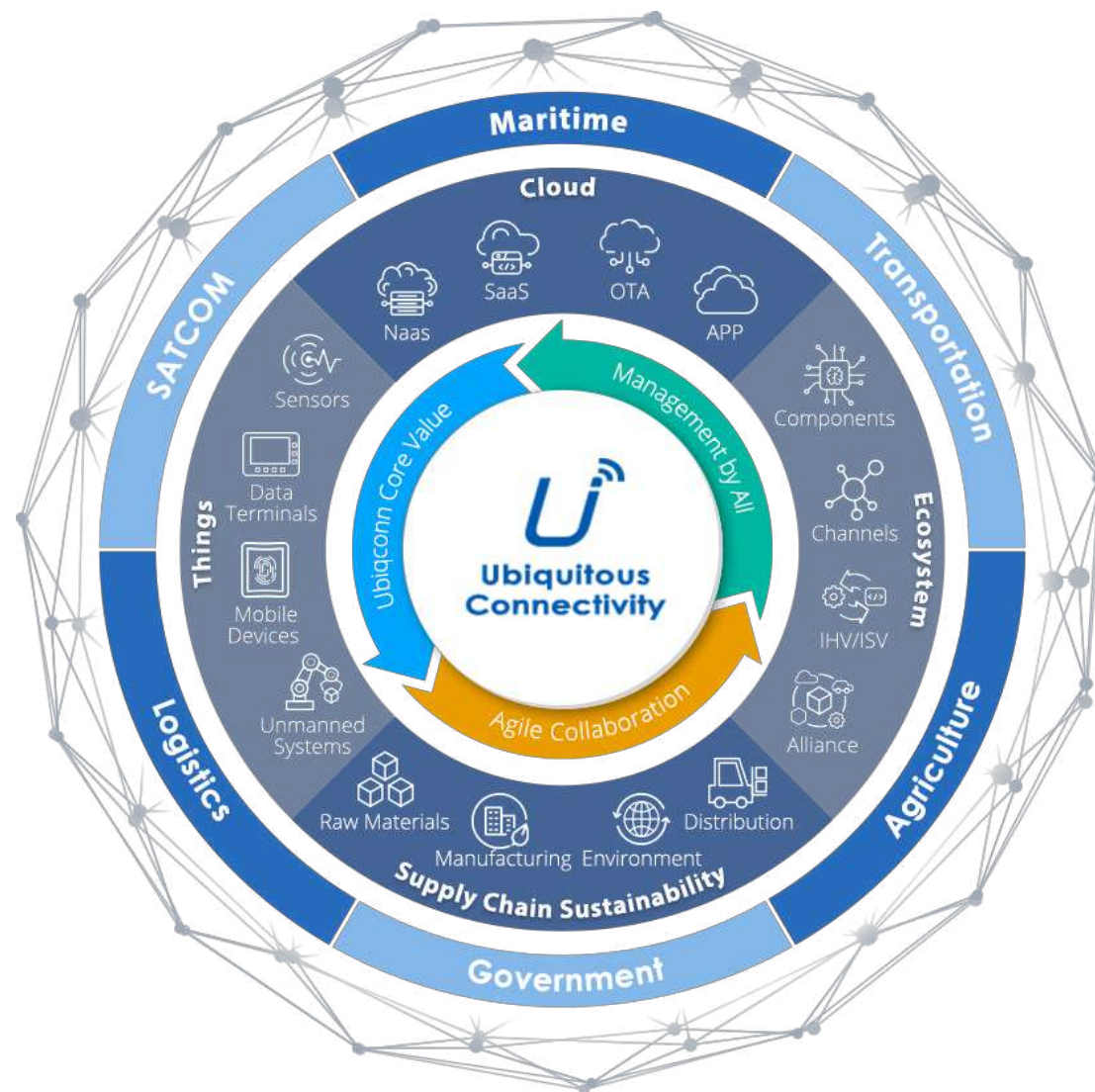
- 品牌

- 擴大銷售通路，貼近市場，提升品牌知名度。
- 提供多樣化結合軟硬體及應用的全方位解決方案。

- 持續投入研發，建立技術壁壘。
- 投資彈性智慧製造，縮短流程，降低成本。



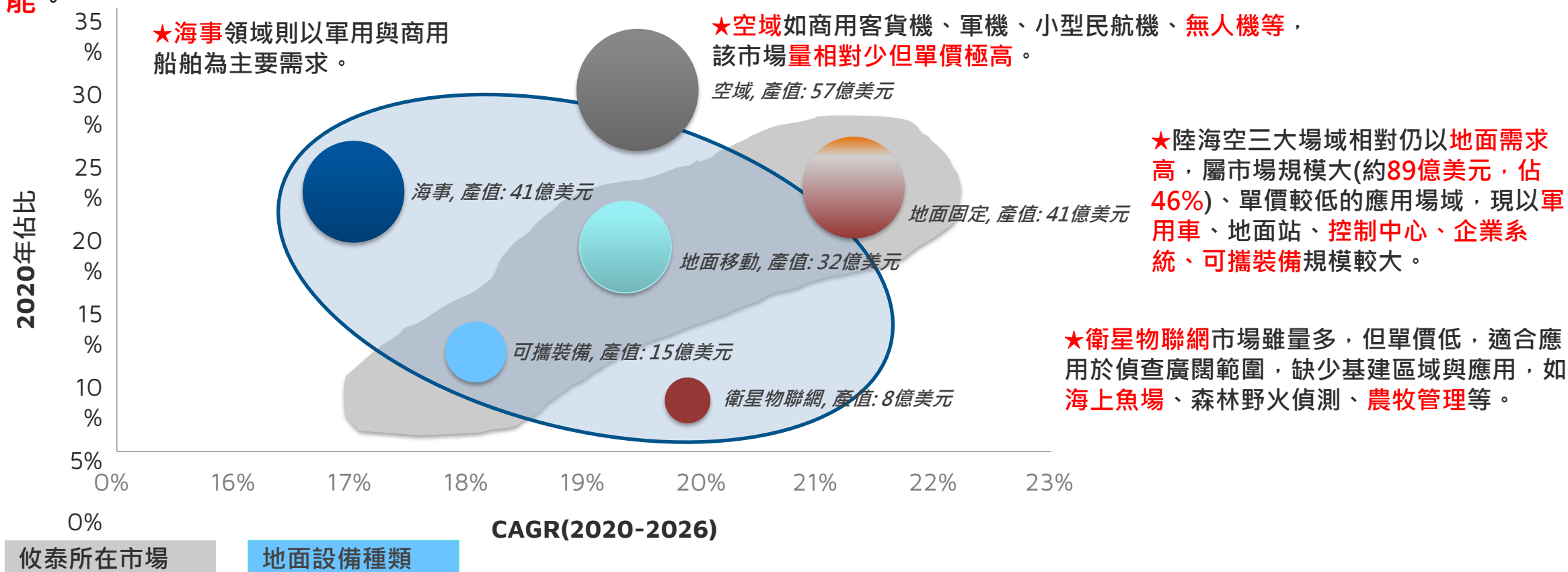
願景 – 無所不在的連結



衛星通訊市場

陸海空三大場域: SATCOM設備CAGR(2017-2021)在6%-8%之間

2021-2027年全球衛星通訊設備市場將聚焦於陸、海、空之**移動式載具**、並拓展至**商業、政府與國防**等應用。未來五年發展潛力伴隨高速連網技術與需求帶動下，預估CAGR(2020-2026)約**19%**，具備**雙位數動能**。



資料來源: Markets&Markets、工研院產科國際所

攸泰衛星應用佈局藍圖

發射載具 →

Phase 3 2023
LEO IoT

Phase 4 2024
LEO Land & Maritime

Phase 2 2022
GEO / MEO Land & Maritime

Phase 1 2011
GNSS





智慧農業 Smart Agriculture Rextrom PX501C



全球防禦 Global Defense Rextorm PM-521



效能運輸 Green Transportation MT7030



智能物流 Intelligent Logistic VULCANX



集團業務成長引擎



核心競爭力

01/

LBS 光機電技術,
已量產應用ARHUD

02/

衛星接受器
整機設計能力

創新能力



既有能力



01/

光纖高階代工
高毛利, 全球客戶
大陸光通訊廠

02/

工業電腦、強固型平板
及無人載具遙控器品牌

03/

高精密電子產品設計
製造服務

以核心競爭力來達成企業永續經營

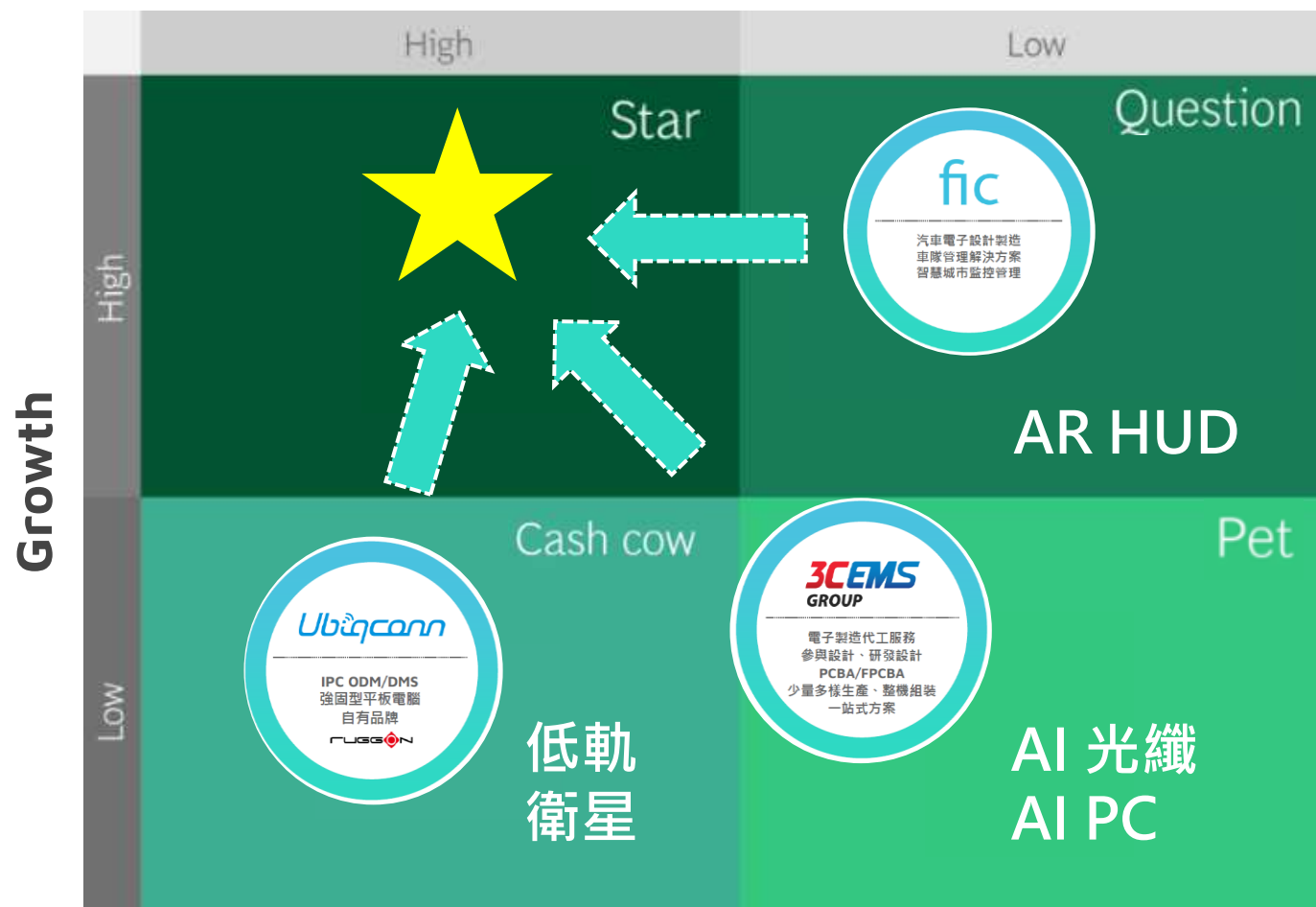
原有製造能力: 與客戶共同設計, 提供少量多樣、整機組裝之一站式生產

創新設計與生產能力: AR HUD、AI傳輸、與衛星接收器等具有市場領先技術的產品



策略佈局 (BCG Growth/Share Matrix)

Market Share



- FICG 的策略佈局：在既有規模與核心能力下，以整合資源、併購、公開發行等方法將主要的產品及技術往明星產業移動
- 短期(1-2年)加速擴大明星產品與事業的市佔，衝刺營收
- 長期(3-5年)投入資源於高成長高獲利的項目



FIC Global Inc.
謝謝您的聆聽

